

电子产品结构工艺



[电子产品结构工艺_下载链接1](#)

著者:任德齐 编

出版者:电子工业出版社

出版时间:2002-6

装帧:平装

isbn:9787505372320

本书是根据教育部《电子产品结构工艺》教学大纲编写的，内容包括：电子产品结构工艺基础、电子产品的防护、印制电路板、电子产品装配工艺、表面安装及微组装技术、

电子设备调试工艺、电子产品技术文件、电子产品结构微型化。本书适于作为中等职业学校电子技术类教材使用。

作者介绍:

目录: 第1章电子产品结构工艺基础(1)

- 11概述(1)
- 111电子产品的特点(1)
- 112电子产品工艺与生产(1)
- 113电子产品结构工艺发展简况(2)
- 114本课程的任务(3)
- 12对电子产品的基本要求(3)
- 121工作环境对电子设备的要求(3)
- 122电子产品的生产及使用要求(4)
- 13电子产品的可靠性(6)
- 131可靠性概述
- • • • • (收起)

[电子产品结构工艺_下载链接1](#)

标签

评论

[电子产品结构工艺_下载链接1](#)

书评

[电子产品结构工艺_下载链接1](#)